

**特点**

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力

**典型应用**

- 仪器设备的直流电源
- 交直流电机控制，电机软启动
- 各种整流电源
- 电焊机，变频器，电池充放电

$I_{F(AV)}$	800A
$V_{RRM}$	100-6500V
$I_{FSM}$	10 KA
$I^2t$	1650 $10^3 a^2 s$

符号	参数	测试条件	结温 $T_J(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 单面散热, $T_C=100^{\circ}C$	150			800	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			1256	A
$V_{RRM}$	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	100		6500	V
$I_{RRM}$	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			50	mA
$I_{FSM}$	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$	150			10.0	KA
$I^2t$	浪涌电流平方时间积					1650	$A^2S*10^3$
$V_{FO}$	门槛电压		150			0.75	V
$r_F$	斜率电阻					0.34	$m\Omega$
$V_{FM}$	正向峰值电压	$I_{FM}=2512A$	25			2.2	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗 (结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				1.72	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗 (壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.080	$^{\circ}C/W$
$V_{iso}$	绝缘电压	50Hz,R.M.S,t=1min, $I_{iso}:1mA(max)$		2500			V
$F_M$	安装扭矩 (M5)					12	N-m
	安装扭矩 (M6)					6	N-m
$T_{stq}$	储存温度			-40		125	$^{\circ}C$
$W_t$	质量					2600	g
Outline	外形						

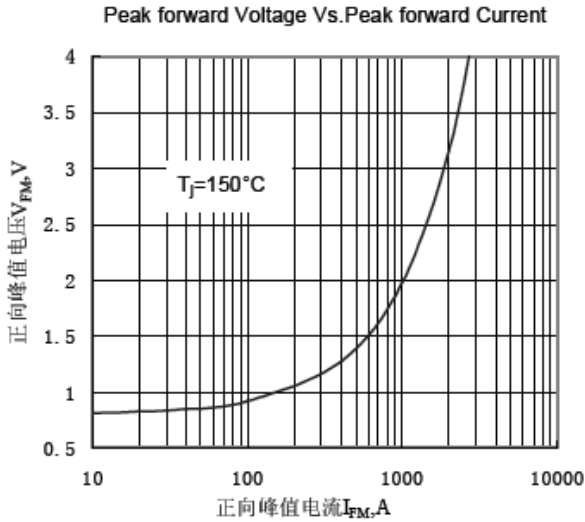


Fig.1 正向伏安特性曲线

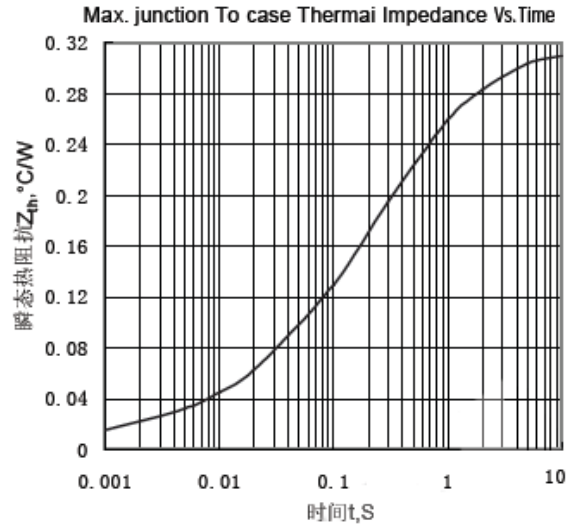


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

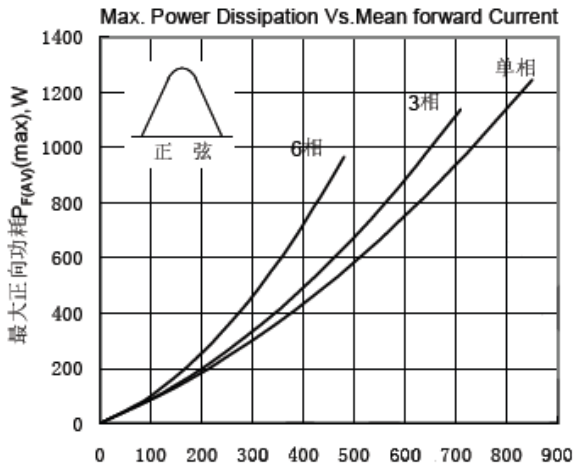


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

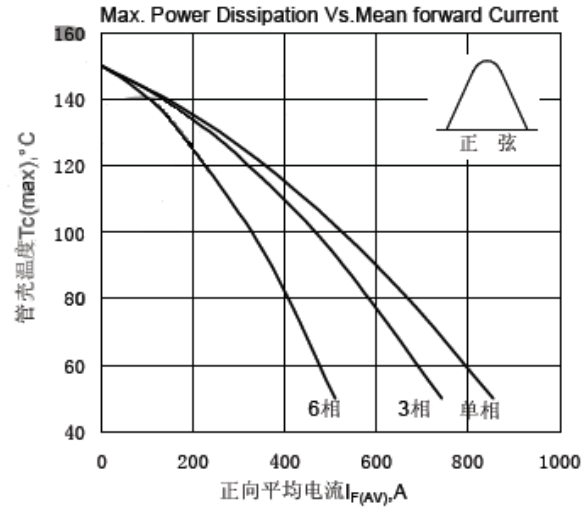


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

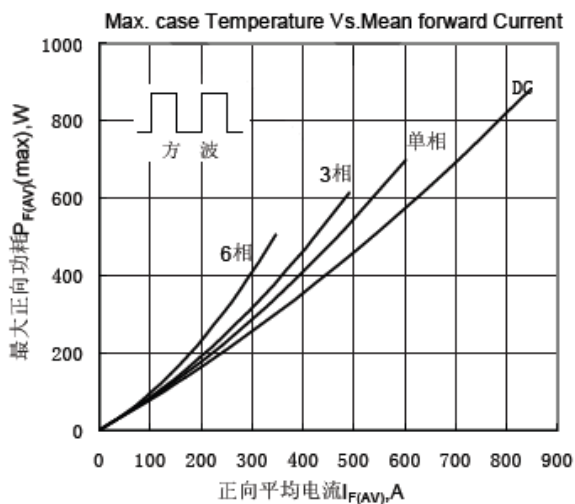


Fig.5 最大正向功耗与平均电流关系曲线

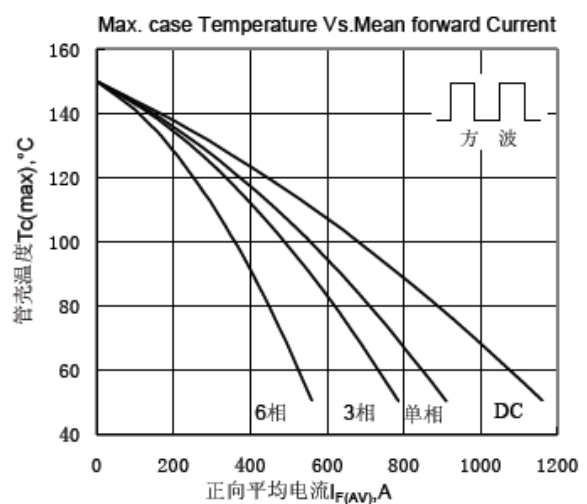


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线

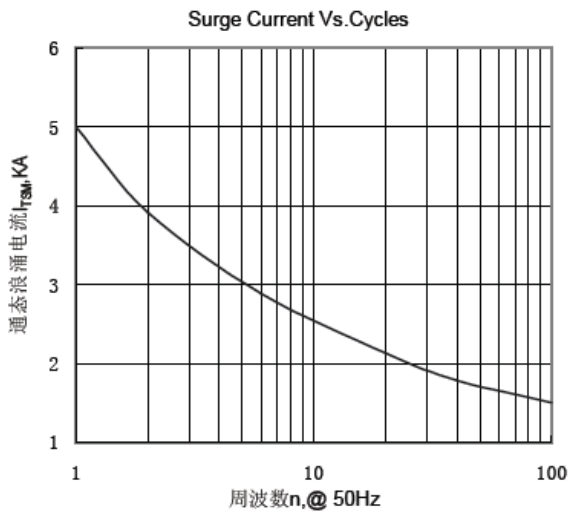


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

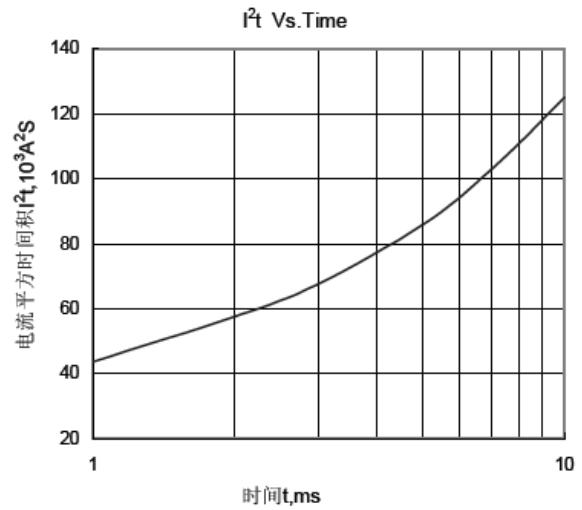


Fig.8  $I^2t$  特性曲线

外形图:

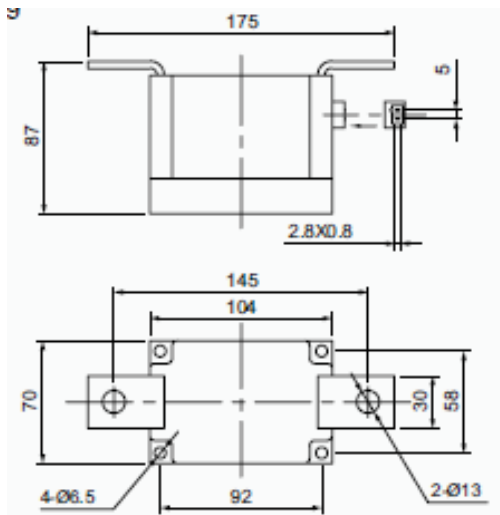


图 1

线路图:

